

社團法人台灣電子設備協會 函

機關地址：110 台北市信義路五
段 5 號 3 樓 3E41 室

聯絡人：楊慧卿小姐

聯絡電話：02-27293933#17

電子郵件：vivi@teeia.org.tw

傳真：02-27293950

受文者：國立高雄科技大學

發文日期：中華民國 112 年 8 月 14 日

發文字號：設備字第 1120814055 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：半導體先進製程與設備模擬種子師資培訓班 DM

主旨：敬邀全國公私立大專院校教師參加「半導體先進製程與設備模擬種子師資培訓班(8/30-31)」。敬請惠予公告並轉知教師踴躍報名參加。

說明：

- 一、在經濟部產業專業人才發展推動計畫指導下，為協助推動技專校院人才發展計畫，培育人才，盼藉由半導體先進製程與設備模擬種子師資培訓班，邀請對半導體製程技術議題有研究的老師，與業界先進一同分享其研究與課程之規劃及授課經驗，期能有助於教師從創新培訓課程的設計及經驗，導入業界人才需求之課程，以提升學生實務之教學品質。
- 二、培訓對象：全國大專院校以上現職教師，預計 20 人(依各校報名先後順序安排學員)
- 三、培訓費用：免費，需自備筆電上課，結業時本會將發給教師種子師資培育時數證明。
- 四、報名方式：網路報名
- 五、報名時間：即日起至 112 年 8 月 28 日，額滿為止。請各校惠予參與培訓人員公(差)假。
- 六、如有相關問題，請逕洽本案聯絡人：台灣電子設備協會 楊小姐，電話：02-27293933 ext.17

正本：公私立大專校院

社團法人台灣電子設備協會

理事長

林士青

國立高雄科技大學



1121013212 112/08/16

- 舉辦日期：112 年 8 月 30-31 日(三四)09:30-16:30 (兩天共 12 小時)
- 課程費用：免費(含講義及午餐)，限大專院校相關系所教師報名，不含教職員及學生。
- 參加人員需自備筆電。
- 報名方式：



1. 網碼報名：

2. 請於報名後，提供教師證或名片影本 e-mail 至 vivi@teeia.org.tw，以利確認查核。

3. 2 日課程皆需出席，結業時將發給教師種子師資培育時數證明。

- 報名聯絡人：

TEL：02-27293933 ext.17 楊小姐, ext.22 鄭小姐

FAX：02-27293950

E-mail：vivi@teeia.org.tw、anne@teeia.org.tw

- 注意事項：

1. 完成線上報名後，系統會發送『報名通知信』至您的 email 信箱，如未收到請來電確認。

2. 為尊重講師之智慧財產權益，恕無法提供課程講義電子檔。

3. 為配合講師時間或臨時突發事件，主辦單位有調整日期或更換講師之權利。

4. 因課前教材、講義準備，若您不克前來，請於開課三日前告知，以利行政作業進行並共同愛護資源。

- 主辦單位保留報名資格之最後審核權利。

半導體先進製程與設備模擬 種子師資培訓班

■ 課程簡介：

在經濟部產業專業人才發展推動計畫指導下，為協助推動技專校院人才發展計畫，培育人才，盼藉由半導體先進製程與設備模擬種子師資培訓班，邀請對半導體製程技術與設備有研究的老師，透過課程了解半導體先進製程與設備分析對於產業界的幫助，並以 COMSOL Multiphysics 軟體來模擬演練，期能有助於教師從培訓課程的設計及經驗，導入業界人才需求之課程，以提升學生實務之教學品質。本次課程針對多重物理量耦合軟體 COMSOL Multiphysics 軟體來模擬解決方案，協助製程/設備開發。歡迎對半導體先進製程與設備模擬的大專院校教師參加。

■ 課程大綱：

| 112年8月30日(三) | | |
|--------------|---|-----------|
| 時間 | 課程大綱 | 講師 |
| 09:30-16:30 | 1. COMSOL Multiphysics 簡介及其半導體產業應用概況 2. COMSOL Multiphysics 基礎建模操作 3. 濕式蝕刻製程模擬 4. 晶片金線封裝模擬 5. 功率電晶體模擬 | 皮托科技專業講師群 |
| 112年8月31日(四) | | |
| 時間 | 課程名稱及大綱 | 講師 |
| 09:30-16:30 | 6. 化學氣相沉積模擬 7. 電漿 ICP 製程設備模擬 8. 電漿 CCP/ICP 製程設備模擬 | 皮托科技專業講師群 |

※主辦單位得因不可抗拒因素，保留本培訓班內容及講師異動之權利。

【開課資訊】

- 主辦單位：財團法人工業技術研究院
- 承辦單位：社團法人台灣電子設備協會
- 舉辦地點：台北市（實際地點請依行前通知為準）